



会社案内

シリコンキャリア
製造業

キャリア インテグレーション 株式会社

《会社概要》

商号 : Carrier Integration株式会社

設立 : 平成22年12月10日

本社 : 茨城県つくば市

資本金 : 22百万円

役員 : 代表取締役 林 恒幸

主な事業 : 各種半導体装置用シリコンキャリア
(SC)の製造及び販売

- ・露光装置用SC
- ・イオン注入用SC
- ・エッチング/デポ用SC

(顧客のメリット)

- ・製造プロセスの生産性向上、コストダウン、品質安定

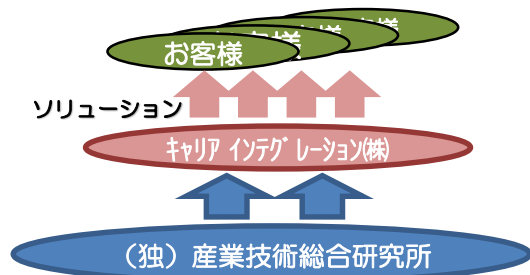
(市場)

日本及び欧米、台湾・韓国市場

事業所 :

〒305-0023 茨城県つくば市上ノ室814番地1

《事業構成》



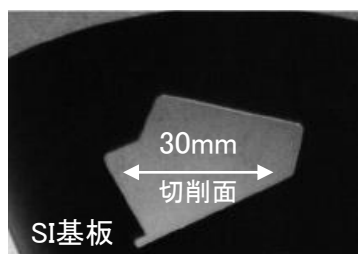
弊社 キャリアインテグレーション(株)は、産総研発のベンチャー企業として、今注目のパワートランジスタ等の新しい半導体ウエハの課題である「シリコン基板に比べて小口径、そして高価で割れやすい・欠けやすい・反りやすい」という問題に対して、そのソリューションを提供する事を目的に2010年12月10日に設立された会社です。

(H23.7.15産総研技術移転ベンチャー称号を授与)

我々は、半導体産業におけるウエハ統合技術の具現化を通し、お客様の満足と信頼を獲得し、半導体産業の発展と社会に貢献致します。

《技術の特徴》

- 高速研削による脆性材料加工
 - シリコン・セラミック・ガラス等
- リニアステージによる精密加工
 - 加工位置精度 : 10 μ m以下
- 超平坦加工
 - 表面粗さ : 0.1 μ m以下
 - 平行度 : 5 μ m(長さ30mm)



シリコンの精密研削 (6万回転/分)



本社工場/加工装置

《主な製品：シリコンキャリア》

- 小口径ウエハ向け搬送用シリコンウエハ
SEMI規格のシリコンウエハ等にくぼみと押さえ機構を加工し、 Φ 1"~6" や口20mm等の化合物半導体ウエハ等を固定の上、搬送・プロセスに使用できる様にした製品。
- 短納期 : 1週間でお手許に (仕様合意後)
- カスタム : 研削形状はお客様仕様で。
- 半導体研究所/各種ラボ用途に最適。

